

证券代码：688288

证券简称：鸿泉技术

公告编号：2026-010

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度
并提供抵押、质押、担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）及合并报表范围内下属子公司浙江鸿泉电子科技有限公司（以下简称鸿泉电子）、上海成生科技有限公司（以下简称成生科技）、上海弦数智能科技有限公司（以下简称弦数智能）、杭州叮咚知途信息技术有限公司（以下简称叮咚知途）、北京域博汽车控制系统有限公司（以下简称域博汽控）等拟向各商业银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元。

● 公司为子公司叮咚知途提供总额不超过人民币0.5亿元的担保。

● 截止本公告披露日，公司对外担保余额为1,000.00万元，为公司对子公司叮咚知途的连带责任担保，无逾期担保情形。

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

（一）情况概述

鉴于公司经营规模进一步扩大，资金需求相应增加，为更好地支持生产经营与业务发展，2026年度公司及合并报表范围内子公司鸿泉电子、成生科技、弦数智能、叮咚知途、域博汽控等拟向各商业银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元。

在综合授信额度内办理流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、

信用证、抵押贷款等综合授信业务，上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为解决向前述金融机构申请综合授信额度所需担保事宜，公司拟使用自有（含控股子公司）的土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保，合计最高抵押或质押金额预计不超过10亿元。公司将结合资金需求情况分批向银行申请，具体融资额度、担保措施等相关内容均以公司与金融机构所签合同约定为准。实际抵押的资产以和金融机构签订的合约为准。

同时为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司叮咚知途的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币0.5亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限根据签订的担保合同为准。

董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信和提供担保有关（包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、金融衍生品、担保、保证等）的合同、协议、凭证等法律文件，授权公司管理层及财务部门办理相关手续。

上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期自2025年年度股东会审议通过本事项之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（二）审议程序

公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于审议〈2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供抵押、质押、担保〉的议案》。本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

公司控股子公司：杭州叮咚知途信息技术有限公司

公司名称	杭州叮咚知途信息技术有限公司
成立日期	2021年12月14日
法定代表人	汪巍

住所	浙江省杭州市滨江区西兴街道启智街 35 号（鸿泉大厦）15 楼 1501 室		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；大数据服务；5G 通信技术服务；智能车载设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；物联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；计算器设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；集成电路销售；电子元器件批发；电子产品销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	为公司控股子公司		
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无		
主要财务数据	项目	2025 年度 /2025 年 12 月 31 日	2024 年度 /2024 年 12 月 31 日
主要财务数据 (万元)	资产总额	1,833.21	1,559.87
	负债总额	1,315.24	1,309.47
	资产净额	517.97	250.40
	营业收入	1,594.23	1,213.51
	净利润	296.75	-531.38
注：以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。			

三、相关授信及担保协议的主要内容

公司尚未签订相关授信及担保协议。上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

四、相关授信及担保的原因及必要性

公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项系2026年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，办理相关事项有助于公司的持续发展。被担保对象叮咚知途为公司合并报表范围内子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力、担保风险总体可控。

五、董事会意见

经审议，公司董事会认为随着商用车行业回暖及乘用车、两轮车等业务的拓展，公司经营规模将进一步扩大，资金需求相应增加，为更好地支持生产经营与业务发展，公司及子公司拟于2026年向各商业银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元，同时拟使用自有（含控股子公司）的土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保，合计最高抵押或质押金额预计不超过10亿元。其次，根据申请授信额度的实际情况，公司为控股子公司杭州叮咚知途信息技术有限公司提供担保事项符合2026年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，被担保对象资产信用情况良好，具有偿还债务能力、担保风险总体可控。以上申请事项的授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。该事项符合公司发展现状，公司董事会同意通过该议案。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为1,000.00万元，为公司对子公司叮咚知途的连带责任担保，无逾期担保情形。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日